



World Best Semiconductor
Packaging and Test Company

엠코테크놀로지코리아(주)

Amkor Technology Korea, Inc. | 서울사업장 (K1) 서울특별시 성동구 동일로 151 (성수동2가 280-8) | Te. 02-460-5114 | Fax. 02-460-6007
| 부평사업장 (K3) 인천광역시 계양구 이대지로 110 (호성동 516-1) | Te. 032-540-3114 | Fax. 032-540-3007
| 광주사업장 (K4) 광주광역시 북구 영고로 100 (대촌동 957) | Te. 062-970-7114 | Fax. 062-970-7007

the First



대한민국 반도체의 역사,
• 앰코코리아가 시작했습니다.

최초

1968년, 국내 기업으로는 최초로 반도체 사업에 착수한 아남반도체.
국내의 전문가들조차 우리의 도전이 무모하며,
'Crazy Business' 라고 만류했습니다.

그렇게 어느 누구도 우리의 성공을 예상하지 않았지만,
결코 우리는 두려워하거나 좌절하지 않았습니다.

1999년, 앰코코리아라는 새로운 이름을 얻게 되었습니다.
비록 이름은 달라졌지만 창업 이래 40년이 넘는 세월 동안
변함없이 대한민국 반도체 산업 발전에 기여하며,
세계 최고의 기술을 바탕으로
반도체 패키징 및 테스트 시장을 선도하여 왔다는 자긍심은
변함이 없을 것입니다.

대한민국 반도체의 역사, 앰코코리아가 시작했습니다.



나노보다 작은 피코에의 도전,
상상을 현실로 만들어 갑니다.

최첨단

'세계 최초 · 세계 최고' 라는 수식어에 걸맞는 성과를
지속적으로 거두어 온 앰코코리아.

40년 이상 쌓아올린 노하우와 독보적인 기술력으로,
반도체 패키징 및 테스트 시장에서

누구도 넘볼 수 없는 경쟁 우위를 확고히 하고 있습니다.

이것이 바로 전자, 반도체, IT 산업을 대표하는 전 세계 200개 이상의 기업들이
앰코코리아와 비즈니스 파트너십을 맺고 싶어하는 이유입니다.

업계 최고의 연구개발 능력과 무한한 발전 역량을 통하여,

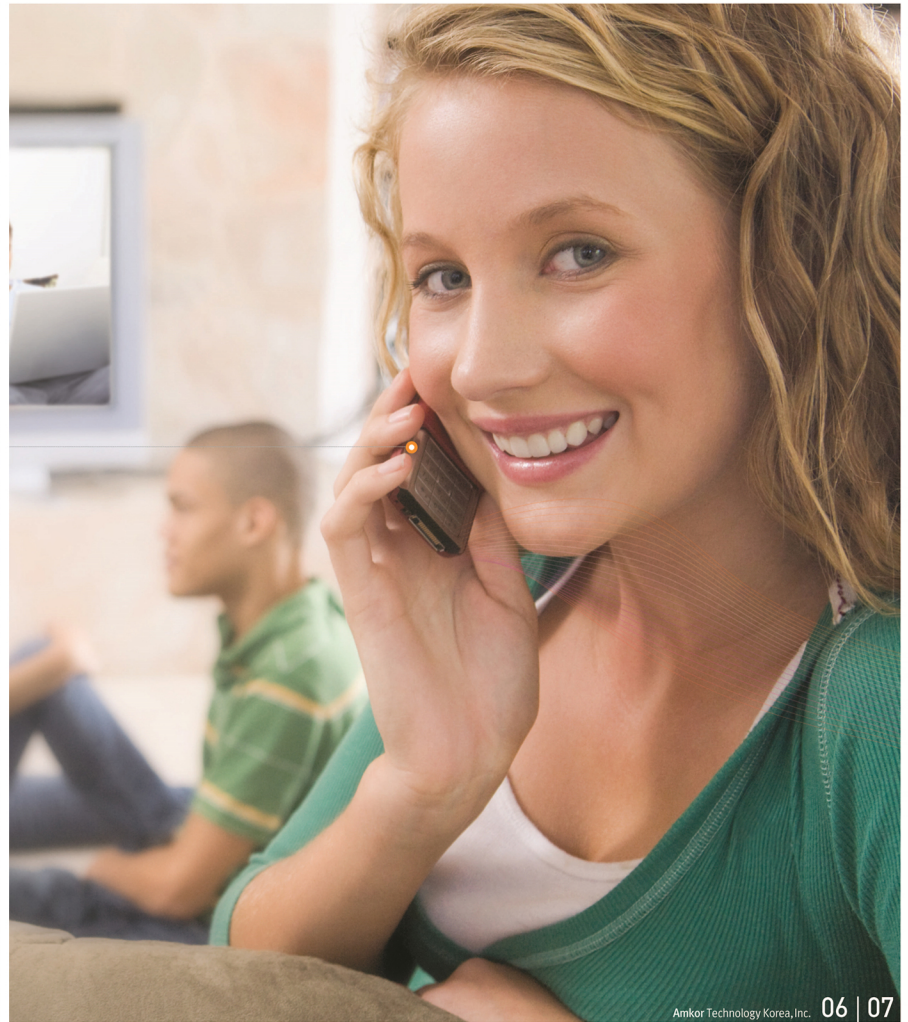
앰코코리아는 앞으로도 우리가 상상하는 기술 그 이상을 실현해 나갈 것입니다.



40단 적층 패키지(40 DIE STACKING)

앰코코리아는 세계 최초로 25 μ m의 메모리칩
40개를 칩스캐일패키징(CSP) 방식으로 쌓아
올리는데 성공하며, 테크놀로지 리더로서의
위상을 확고히 하였습니다.

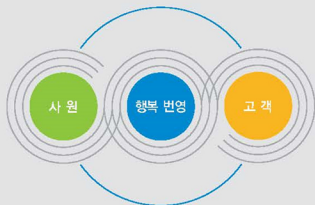
Beyond



○ Vision



사원과 고객이 모두 행복한 기업,
앰코가 꿈꾸는 미래입니다.



사원과 고객의 행복과 변명을 추구하는 기업.
우리 앰코코리아는 최고의 서비스와 기술 리더십으로,
고객이 진정으로 만족하고 지속적으로 성장할 수 있도록
고객의 행복과 변명을 위해 최선을 다할 것입니다.
앰코코리아가 추구하는 미래는
일과 삶의 균형을 통한 가치창출의 극대화로
회사와 개인의 발전은 물론,
공급적으로 고객, 협력업체, 사회 전체가
다같이 행복해지는 것입니다.

○ Management Philosophy



고객과 사원이 함께 성장하여,
사회에 공헌하는 기업입니다.



Customer

고객을 위한 가치창조로 고객과 함께 성장해 나갑니다.

Technology

새로운 가능성에 도전하며 반도체 미래를 실현합니다.

Talent

구성원의 창의성과 능력을 존중하고,
자기 발전과 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공합니다.

Responsibility

기업의 사회적 책임을 다하며 아름다운 사회 만들기에 앞장섭니다.



엠코코리아의 반도체 기술이 세상을 변화시키고 있습니다.

안녕하십니까?

반도체 라는 용어조차 생소했던 1968년, 국내 기업 최초로 반도체 사업에 착수했던 그 순간부터, 엠코코리아가 걸어온 길은 곧 한국 반도체 산업의 역사였습니다. 반도체 산업의 가치를 깨달아 보았던 통찰력과 과감한 도전정신, 그리고 고객을 소중히 여기고 모든 일에 진심을 다하는 신의(信義)를 바탕으로, 엠코코리아는 지속적으로 성장하여 왔습니다.

40년이 넘는 세월 동안 세계 반도체 패키징과 테스트 산업을 대표하는 이름으로 굳건히 자리매김하여 왔지만, 엠코코리아가 개발해 온 것은 단순한 제품과 기술만이 아니었습니다. 인류의 삶을 보다 편리하고 아름답게 만들고 싶다는 열망과 오늘보다 더 나은 내일을 가능하게 한다는 자긍심으로 언제나 새로운 가치를 창조하고자 최선을 다했습니다.

세계 최고의 기술력은 누구나 이룰 수 있는 것은 아닙니다. 한 분야를 대표하는 글로벌 리더가 되는 것도 어느 기업에서나 가능한 것은 아닙니다. 엠코코리아는 "사원과 고객의 행복과 번영"을 향한 끊임없는 열정으로, 이 모든 것을 현실로 만들어 왔습니다.

이제 엠코코리아는 창조적인 발상, 역동적인 에너지, 미래지향적인 기술 개발 역량을 통한 성장동력을 확보하며, '백년 기업'의 이상을 실현하기 위해 힘차게 도약할 것입니다. 또한 신의를 바탕으로 원화와 기본을 지키는 상생과 인간존중의 기업문화를 확립하기 위한 노력도 지속적으로 기울여 나갈 것입니다.

반도체의 미래를 선도하며, 앞으로도 여러분에게 보다 풍요롭고 행복한 삶을 선사해 나가겠습니다. 따뜻한 격려와 관심으로 엠코코리아가 만들어가는 아름다운 디지털 세상을 지켜봐 주시기 바랍니다.

감사합니다.

대표이사장 김주호

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kim Ju-ho'.

앵코가 세상을 바꾸어 나가고 있습니다.

지금 이 순간에도 미주와 유럽, 아시아 등 세계 각지에 지리한 영업사무소와 5개국 11개 글로벌 생산기지에서, 20,000여명 이상의 앵코인들이 세상을 바꾸어 나가고 있습니다.



앵코 (미국 본사)



앵코코리아(서울)



앵코코리아(부산)



앵코코리아(광주)



중국 (Shanghai)



필리핀 (Laguna)

● Headquarters

미국
Chandler,
Arizona, USA

● Sales Office

미국
Santa Clara, Irvine
Greensboro, Dallas
Stoneham, San Diego

유럽
Archamps(France)

일본
Tokyo

한국
서울

● 생산기지

한국 K1 - 서울 K3 - 부평 K4 - 광주	필리핀 P1 - Muntinlupa City P3 - Laguna P4 - Laguna	대만 T1 - Tao Yuan County T3 - Hsinchu County T5 - Hsinchu County
중국 C3 - Shanghai	일본 J1 - Iwate	



필리핀 (Muntinlupa)



대만 (Taoyuan)



대만 (Hsinchu)



대만 (Hsinchu)



일본 (Iwate)

백년기업 힘찬 도약

1968년 대한민국 최초로 시작한 반도체 사업, 신의를 바탕으로 고객의 행복과 번영을 위한 끊임없는 열정으로 함께했습니다. 앵코는 지속성장 기업으로 힘차게 도약할 것입니다.

- 1968.03 한국 기업 최초로 반도체 사업 착수(아남산업주식회사)
- 1968.04 미국 필리델피아에 반도체 패키징 영업 및 마케팅 회사 앵코일렉트로닉스(현 앵코테크놀로지) 설립
- 1970.03 반도체 생산 및 수출 개시
- 1973.02 수출유공 대통령 표창장 수상
- 1973.11 제10회 수출의 날 금탑산업훈장 수상
- 1974.11 제11회 수출의 날 수출 특별유공 대통령기 수상
- 1977.09 아남산업 기업공개 및 주식 상장
- 1979.11 제16회 수출의 날 1억불 수출탑 수상
- 1983.11 제20회 수출의 날 2억불 수출탑 수상
- 1997.04 반도체 패키징 K4(광주)공장 준공 (광주광역시 첨단과학산업단지 내 13만평)
- 1998.03 아남반도체주식회사로 상호 변경 (신新) CI 선포
- 1998.05 앵코, 나스닥(NASDAQ) 상장 (종목코드 : AMKR)
- 1999.02 앵코테크놀로지코리아주식회사(앵코코리아) 설립
- 2000.11 제5회 외국인투자기업상 수상
- 2001.01 일본에 도시바와 합작 공장 설립
- 2001.03 중국에 반도체 패키징 공장 설립
- 2001.07 대만에 반도체 패키징 공장 설립
- 2002.05 일본 시티즌 위치의 어셈블리 사업부 인수
- 2004.02 대만 FICTA의 어셈블리 사업부 인수
- 2004.05 IBM의 싱가포르 테스트 공장 인수
- 2004.08 유니타브(Unitive) 인수
- 2006.09 IBM, Chartered, 삼성과 커넥 플랫폼 기술 제휴
- 2006.11 제43회 무역의 날, 5억불 수출탑 수상
- 2007.11 제44회 무역의 날, 6억불 수출탑 수상
- 2007.12 반도체 단일품목 수출누계 800억 돌파
- 2008.05 앵코코리아, 반도체사업 착수 40주년
- 2009.04 도시바, 나카가와 시스템 LS 패키징 및 테스트 사업 합작 투자 양해각서 체결
- 2009.08 '2009 글로벌 기술혁신상' 수상 (TMV PoP, FusionQuad®, FcM8GA 패키지) 텍사스인스트루먼트(TI)사와 함께 세계 최초 Copper Pillar를 이용한 40μm 미세 피치 플립칩(Fine Pitch Flip Chip) 개발 및 양산
- 2010.07